

CHIPS Act statunitense, finalizzato l'accordo con SK hynix: quasi un miliardo per portare la memoria HBM nell'Indiana

https://www.trendynet.it/wp-content/uploads/2024/12/localimages/sk-hynix-hbm3e-12-layer_720.jpg, SK Hynix ha ottenuto un finanziamento di 958 milioni di dollari dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per costruire un impianto avanzato di packaging di chip e un centro di ricerca in Indiana. L'investimento totale previsto è di 3,87 miliardi di dollari, con la creazione di 1.000 posti di lavoro...

[Read More](#)